

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 7 月 23 日 (2009.7.23)

【公表番号】特表 2008-544555 (P2008-544555A)

【公表日】平成 20 年 12 月 4 日 (2008.12.4)

【年通号数】公開・登録公報 2008-048

【出願番号】特願 2008-518423 (P2008-518423)

【国際特許分類】

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 6 月 3 日 (2009.6.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

メッシュパターンの形成された第 1 の表面を有するダイを提供する工程と、
第 1 の層の表面によって支持される金属層を含む第 1 の物品を提供する工程と、前記金
属層は第 1 の形状であることと、
第 1 の層と異なる第 2 の層によって支持される光活性材料を含む第 2 の物品を提供する
工程と、
第 2 の物品とダイとの間に第 1 の物品を配置する工程と、
第 1 の物品が第 2 の物品とダイとの間にあるときに、金属層が第 1 の形状から第 1 の形
状と異なる第 2 の形状である金属メッシュへ変化するように第 1 の層の前記表面とダイの
第 1 の表面とを接触させることによって、金属メッシュ、光活性材料、および第 2 の層を
含む第 3 の物品を形成する工程を含む方法。

【請求項 2】

ダイの第 1 の表面が第 1 の層と接触しているとき、約 1 0 0 以上までダイを加熱する
工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

ダイの第 1 の表面が第 1 の層と接触しているとき、約 3 0 0 以上までダイを加熱する
工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

ダイの第 1 の表面が第 1 の層と接触しているとき、ダイに約 0 . 6 8 9 M P a (約 1 0
0 p s i) 以上の圧力を加える工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

ダイの第 1 の表面が第 1 の層と接触しているとき、ダイに約 6 . 8 9 5 M P a (約 1 ,
0 0 0 p s i) 以上の圧力を加える工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 6】

ダイの第 1 の表面が第 1 の層と接触しているとき、ダイに約 3 4 . 4 7 M P a (約 5 ,
0 0 0 p s i) 以上の圧力を加える工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 7】

第 2 の物品とダイとの間に第 1 の物品を配置する前に、金属層と第 1 の層との間に放出
層を配置する工程を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 8】

放出層はポリエステルまたはポリエチレンを含む請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

金属層は、アルミニウム、鉄、金、銀、銅、ニッケル、パラジウム、白金、チタンまたはそれらの合金を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 10】

第 3 の物品は、基板と金属メッシュとの間に光活性材料を含む光電池を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 11】

ダイの第 1 の表面のうちの少なくとも一部は平坦面または湾曲面である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 12】

第 1 の層および第 2 の層のうちの 1 つ以上はフレキシブル基板を含む請求項 1 に記載の方法。